



平成27年3月24日

各 位

会 社 名 株式会社RS Technologies

代表者名 代表取締役社長 方 永義

(コード番号：3445 東証マザーズ)

問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 正行

(TEL)03(5709)7685

東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ

当社は、本日、平成27年3月24日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。今後とも、なお一層のご指導とご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、当社グループの当期の業績予想は以下のとおりであり、また、最近の決算情報等につきましては別添のとおりであります。

【連結】

(単位：百万円、%)

	平成27年12月期 (予想)			平成27年12月期 第2四半期累計期間 (予想)		平成26年12月期 (実績)	
		構成比	対前期 増減率		構成比		構成比
売上高	5,486	100.0	20.2	2,496	100.0	4,566	100.0
営業利益	927	16.9	Δ20.4	314	12.6	1,166	25.5
経常利益	849	15.5	Δ32.0	283	11.3	1,247	27.3
当期(四半期)純利益	420	7.7	Δ36.7	80	3.2	664	14.5
1株当たり 当期(四半期)純利益	78円42銭			15円14銭		131円90銭	
1株当たり配当金	-			-		-	

- (注) 1. 平成26年12月期(実績)の1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。
2. 平成26年9月9日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。上記では、平成26年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益を算出しております。
3. 平成27年12月期(予想)及び平成27年12月期第2四半期累計期間(予想)の1株当たり当期(四半期)純利益は、公募予定株式数(330,000株)を含めた予定期中平均発行済株式数により算出しております。なお、当該株式数には、オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当増資分(最大162,000株)は含まれておりません。
4. 平成27年2月17日開催の取締役会において承認された平成26年12月期の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しておりますが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査は未了であり、監査報告書は受領しておりません。
5. 平成27年12月期につきましては、当社三本木工場において新たな製造設備を導入し生産能力の増強を図るとともに、半導体受託生産企業が集中する台湾において工場を新設することを予定しております。これに伴い、新たな製造設備取得に伴う減価償却費の増加及び既存設備移設に伴う特別損失の発生を見込んでおります。

以 上

ご注意：本資料に記載されている当社グループの当期の連結業績予想は、本資料の日付時点において入手可能な情報による判断及び仮定を前提としており、実際の業績は様々な要因によって異なる場合があります。



平成26年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年3月24日

上場会社名 株式会社RS Technologies 上場取引所 東
 コード番号 3445 URL <http://www.rs-tec.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 方 永義
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 鈴木 正行 (TEL) 03(5709)7685
 定時株主総会開催予定日 平成27年3月30日 配当支払開始予定日 —
 有価証券報告書提出予定日 平成27年3月30日
 決算補足説明資料作成の有無 : 無
 決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年12月期の連結業績(平成26年1月1日～平成26年12月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年12月期	4,566	—	1,166	—	1,247	—	664	—
25年12月期	—	—	—	—	—	—	—	—
(注) 包括利益	26年12月期		694百万円(—%)		25年12月期		—百万円(—%)	

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
26年12月期	131.90	—	43.3	18.3	25.5
25年12月期	—	—	—	—	—

(参考) 持分法投資損益 26年12月期

—百万円

25年12月期

—百万円

(注) 1. 当社は、平成25年12月期については、連結財務諸表を作成していないため、平成25年12月期の数値及び平成26年12月期の対前年増減率は記載しておりません。また、自己資本当期純利益率及び総資産経常利益率は連結初年度のため、それぞれ期末自己資本及び期末総資産に基づいて算出しております。

2. 当社は、平成26年9月9日付けで株式1株につき500株の株式分割を行っており、当連結会計年度の期首に分割が行われたと仮定して、「1株当たり当期純利益」を算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
26年12月期	6,823	1,596	22.5	300.54
25年12月期	—	—	—	—

(参考) 自己資本

26年12月期

1,535百万円

25年12月期

—百万円

(注) 1. 平成26年12月期より連結財務諸表を作成しているため、平成25年12月期の数値については記載しておりません。

2. 当社は、平成26年9月9日付けで株式1株につき500株の株式分割を行っており、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「1株当たり純資産」を算定しております。

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
26年12月期	643	△3,215	3,066	951
25年12月期	—	—	—	—

連結キャッシュ・フローの状況に関する注記

(注) 平成26年12月期より連結財務諸表を作成しているため、平成25年12月期の数値については記載しておりません。

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産 配当率 (連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
25年12月期	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—
26年12月期	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—
27年12月期(予想)	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—

(注) 平成26年12月期より連結財務諸表を作成しているため、平成25年12月期の配当性向及び純資産配当率については記載していません。

3. 平成27年12月期の連結業績予想(平成27年1月1日～平成27年12月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	2,496	—	314	—	283	—	80	—	15.14
通 期	5,486	20.2	927	△20.4	849	△32.0	420	△36.7	78.42

(注) 1. 平成27年12月期(予想)の1株当たり当期純利益は、公募株式数330,000株を含めた予定期中平均発行済株式数により算出し、オーバーアロットメントによる売出しに関する第三者割当増資(最大162,000株)は考慮していません。

2. 当社は、平成26年12月期より連結財務諸表を作成しているため、対前年同四半期増減率は記載していません。

※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 有
新規 1社(社名)艾爾斯半導體股份有限公司 除外 - 社(社名)

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
② ①以外の会計方針の変更 : 無
③ 会計上の見積りの変更 : 無
④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	26年12月期	5,110,000株	25年12月期	—株
② 期末自己株式数	26年12月期	—株	25年12月期	—株
③ 期中平均株式数	26年12月期	5,036,164株	25年12月期	—株

(注) 当社は、平成26年9月9日付で普通株式1株につき、500株の割合で株式分割を実施いたしました。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して株式数を算定しております。

(参考) 個別業績の概要

1. 平成26年12月期の個別業績 (平成26年1月1日～平成26年12月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年12月期	4,566	31.4	1,190	69.4	1,293	58.0	710	35.3
25年12月期	3,475	142.5	702	—	818	—	524	957.5
	1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益					
		円 銭		円 銭				
26年12月期		141.00		—				
25年12月期		104.96		—				

(注) 当社は、平成26年9月9日付けで株式1株につき500株の株式分割を行っており、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり当期純利益」を算定しております。

(2) 個別財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭	
26年12月期	6,046	25.8	1,557	25.8	1,557	25.8	304.86	
25年12月期	2,320	28.0	649	28.0	649	28.0	129.95	

(参考) 自己資本 26年12月期 1,557百万円 25年12月期 649百万円

(注) 当社は、平成26年9月9日付けで株式1株につき500株の株式分割を行っており、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「1株当たり純資産」を算定しております。

※ 監査手続の実施状況に関する表示

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「1. 経営成績・財政状態に関する分析(1)経営成績に関する分析③次期の見通し」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績・財政状態に関する分析	2
(1) 経営成績に関する分析	2
(2) 財政状態に関する分析	2
(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当	4
(4) 事業等のリスク	4
2. 経営方針	7
(1) 会社の経営の基本方針	7
(2) 目標とする経営指標	7
(3) 中長期的な会社の経営戦略	7
(4) 会社の対処すべき課題	8
3. 連結財務諸表	9
(1) 連結貸借対照表	9
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	11
(3) 連結株主資本等変動計算書	13
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	14
(5) 連結財務諸表に関する注記事項	15
(継続企業の前提に関する注記)	15
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)	15
(追加情報)	16
(連結貸借対照表関係)	16
(連結損益計算書関係)	17
(連結包括利益計算書関係)	18
(連結株主資本等変動計算書関係)	18
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)	18
(金融商品関係)	19
(デリバティブ取引関係)	21
(ストック・オプション等関係)	21
(税効果会計関係)	24
(セグメント情報等)	25
(関連当事者情報)	27
(1株当たり情報)	28
(重要な後発事象)	28

1. 経営成績・財政状態に関する分析

(1) 経営成績に関する分析

①当期の経営成績

当連結会計年度の世界経済は、米国においては、企業の設備投資の回復などから緩やかな回復傾向が続いているものの、欧州の景気低迷は長期化し、新興国においても成長ベースに陰りが見られるなど不透明な状況が続いております。一方、国内においては、消費税引き上げの影響により個人消費の回復が遅れておりますが、輸出企業を中心とした企業収益の回復により景気は緩やかな回復基調となりました。

当社グループの参画しております半導体業界においては、スマートフォンやタブレット端末の市場の拡大が続いたこと等により事業環境は概ね好調に推移しました。

このような状況の中、当連結会計年度における当社グループの売上高は4,566,080千円となりました。営業利益は1,166,080千円、経常利益は為替差益等の営業外収益258,707千円、シンジケートローン手数料等の営業外費用176,841千円を計上し1,247,946千円となり、当期純利益664,261千円となりました。

なお、平成26年2月24日付で当社の連結子会社として艾爾斯半導體股份有限公司を設立したことに伴い、当連結会計年度より連結財務諸表を作成したため、前連結会計年度との比較は記載しておりません。

②セグメント別の概況

セグメント別の業績は次のとおりであります。

(ウェーハ事業)

当事業におきましては、台湾向けのシリコンウェーハ再生事業の拡大等により売上高は4,414,457千円、セグメント利益（営業利益）は1,444,913千円となりました。

(ソーラー事業)

当事業につきましては、安定した日射量により売上高は40,621千円、セグメント利益（営業利益）は22,478千円となりました。

(その他)

その他は、半導体生産設備の買取・販売と技術コンサルティングの業績を示しており、売上高は111,002千円、セグメント利益（営業利益）は38,815千円となりました。

③次期の見通し

次期の見通しにつきましては、以下のとおりとなっております。

三本木工場の新規生産ラインの稼働、国内工場で培ってきた生産技術と生産方法による台湾工場の量産立ち上げにより、生産能力の増強を図り国内・海外のシリコンウェーハ再生事業の拡大を図っていく計画です。なお、次期はこれに伴い、新たな製造設備取得に伴う減価償却費の増加及び既存設備移設に伴う特別損失の発生を見込んでおります。

このような見通しのもと、次期（平成27年12月期）の連結業績見通しにつきましては、売上高54億86百万円（前期比20.2%増）営業利益9億27百万円（前期比20.4%減）、経常利益8億49百万円（前期比32.0%減）、当期純利益4億20百万円（前期比36.7%減）を見込んでおります。

(2) 財政状態に関する分析

(資産、負債及び純資産の状況)

①資産の部

流動資産は2,759,317千円となりました。主な内訳は、現金及び預金1,190,277千円、受取手形及び売掛金696,764千円、商品及び製品376,262千円となっております。

固定資産は4,064,322千円となりました。主な内訳は、機械装置及び運搬具361,604千円、建設仮勘定3,543,784千円、長期貸付金65,699千円となっております。

②負債の部

流動負債は2,292,855千円となりました。主な内訳は、短期借入金483,180千円、1年内返済予定の長期借入金344,049千円、未払金767,303千円、未払法人税等408,323千円となっております。

固定負債は2,934,689千円となりました。主な内訳は、長期借入金2,925,959千円となっております。

③純資産の部

純資産合計額は1,596,094千円で、自己資本比率は、22.5%となりました。

なお、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度との対比は行っておりません。

(キャッシュ・フローの状況)

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は951,027千円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度において営業活動の結果増加した資金は643,351千円となりました。

主な増加要因は、税金等調整前当期純利益1,228,303千円を計上したことによるものです。また主な減少要因は為替差益82,820千円、未消費税等の増加額133,017千円、法人税等の支払額488,481千円によるものであります。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度において投資活動の結果減少した資金は3,215,793千円となりました。

主な減少要因は、シリコンウェーハ製造設備及び研究開発設備等に伴う有形固定資産の取得による支出2,901,031千円によるものであります。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度において財務活動の結果増加した資金は3,066,993千円となりました。

主な増加要因は、長期借入れによる収入2,619,298千円によるものであります。また主な減少要因は、長期借入金の返済による支出146,904千円によるものであります。

なお、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度との対比は行っておりません。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成26年12月期
自己資本比率 (%)	22.5
時価ベースの自己資本比率 (%)	—
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	5.8
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	26.2

自己資本比率：自己資本/総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い

(注1) いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

(注2) 時価ベースの自己資本比率につきましては、当連結会計期間末において非上場であり、時価総額の算出が困難なため、記載を省略しております。

(注3) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

(注4) 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。

(注5) 利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当期末の配当につきましては、今後も継続して設備投資を実施して行く必要があることから、当面は必要な内部留保を確保しつつ、配当は実施せず、設備投資の継続に備えて資金の確保を優先する方針であります。また、次期の配当につきましても同様とさせていただき予定であります。しかしながら、株主に対する利益の還元は当社にとって最も重要な経営の課題として認識しており、財務体質の改善・強化及び中期計画の達成等の状況を勘案しながら配当を実施することを検討していきます。

(4) 事業等のリスク

本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。また、以下の記載は投資に関連するリスクを全て網羅するものでない点に留意する必要があります。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

① 特定の取引先への依存に関するリスク

当社グループは、世界有数の半導体受託生産企業であるTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd (TSMC)との円滑な取引を継続しており、同社に対する売上高が当社グループの売上高に占める割合は、第4期事業年度38.6%、第5期連結会計年度38.3%と高い割合となっております。

従って、同社の販売及び設備投資の動向によっては当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

② 業界動向に関するリスク

当社グループの主な需要先は半導体業界であります。需給の変動があった場合、シリコンウェーハの使用量の減少や販売価格の低下により当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

③ 他社との競合に関するリスク

当社グループの主たる事業領域である半導体市場は、国内外を問わず厳しい競合環境にあり、同業他社との間では価格、品質、顧客対応能力、新製品開発力等、様々な局面での競争が展開されています。

当社グループは、ウェーハ事業において高い価格競争力を有する様々なテスト用半導体ウェーハを手掛けることにより、収益源を確保すると共に半導体需給や技術動向の把握及び顧客層や製品分野の拡大を図っていますが、高シェア製品の市場支配力が低下することにより競争上の地位が低下した場合、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

④ 外注先の品質管理に関するリスク

当社グループは、ウェーハ事業の加工工程を外部企業に一部委託しています。当社グループでは、委託先企業の経営状況、技術水準、製造能力について継続的に監視していますが、委託先企業が、必要な技術的・経済的資源を維持するとともに十分な製品の品質を保ち、当社グループが求める水準の委託業務を遂行できる保証はありません。

また、これらの委託先において何らかの理由により事業が中断された場合、当社グループ製品の加工及び製品の供給に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 加工工程に関するリスク

当社グループの主たる事業領域である半導体市場では、製品価格が継続的に低下する傾向にあります。当社グループでは、生産プロセスの見直し等により生産効率の向上を進め、製品価格低下の影響を緩和するように努めていますが、一般的に生産効率の向上には限界があるため、製品価格の低下が続き、かつ、継続的に生産効率を向上させることができなくなった場合、利益が圧迫される可能性があります。さらに、加工工程において、何らかの理由により加工活動が中断してしまった場合、生産能力低下や納期遅延が発生し、ウェーハの供給が困難となる可能性があり、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を与えるリスクがあります。

⑥ 設備投資及び資金調達に関するリスク

当社グループは、市場動向、需要動向等を見極めながら、事業戦略及び当該投資の収益性等を勘案しつつ必要な設備投資を実施していく方針です。平成27年1月31日現在、以下のとおり設備の新設を計画しております。

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	投資予定金額		資金調達 方法	着手及び完了予定年月		完成後の 増加能力
				総額 (千円)	既支払額 (千円)		着手	完了	
提出会社	三本木工場 (宮城県大崎市)	ウェーハ事業	シリコンウェーハ製造設備及び開発研究設備	5,360,000	4,927,728	借入金及び補助金	平成26年9月	平成27年3月	現状の約20%増
艾爾斯半導體股份有限公司	台湾工場 (台湾台南市)	ウェーハ事業	シリコンウェーハ製造設備	2,586,505	1,057,891	借入金、自己資金及び増資資金	平成26年6月	平成27年6月	新規(現状の約50%相当)

当該設備投資については、半導体市場での需要増、特に台湾顧客からの受注増を受け、当社三本木工場において新たな製造設備を導入し生産能力の増強を図るとともに、半導体受託生産企業が集中する台湾において工場を新設することで売上高の拡大を図るものです。

大規模な設備投資を行った場合、製造ラインの調整等を行う必要があることから、本格的な生産に至るまでには一定の期間を要するため、減価償却費が先行的に発生することになります。

また、取得を予定している半導体検査装置、半導体洗浄装置等の各種製造設備については、現在の当社の収益規模及び財務規模と比較すると相対的に高額の水準となっており、今後減価償却費が大幅に増加する可能性があります。

これらの要因により、今後当社グループの利益率が大幅に悪化する可能性があります。また、当該設備投資を行う際に想定していた受注を期待通りに獲得できなかった場合には、当社グループの経営成績等は重大な影響を受ける可能性があります。

また、当社グループは、事業展開の必要に応じて機動的な資金調達を実施していく方針ですが、当該資金調達に際しては、当社グループの財政状態、収益性等のほか、金利水準や市場環境等の要因により、当社グループが希望する時期または条件により資金調達を実行できない場合があり、そのような場合には、必要な設備投資を行うことができず、事業計画等において想定していた収益を上げられない可能性があります。当社グループの事業、経営成績及び財政状態に重大な影響を与えるリスクがあります。

⑦ 為替の変動に関するリスク

当社グループの輸出比率は、第4期事業年度71.3%、第5期連結会計年度73.7%と年々高くなってきており、為替変動の影響を強く受けてきております。このため、為替相場の急激な変動によっては当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

⑧ 配当政策に関するリスク

当社グループは、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としておりますが、設立以来、財務体質の改善・強化を優先し、配当を実施していません。また今後も継続して設備投資を実施して行く必要があることから、当面は必要な内部留保を確保しつつ、配当は実施せず、設備投資の継続に備えて資金の確保を優先する方針であります。しかしながら、株主に対する利益の還元を経営の重要課題として認識しており、財務体質の改善・強化及び設備投資の状況を勘案しながら配当を実施することを検討していきます。

⑨ 特定人物への依存に関するリスク

現在、当社グループの経営は代表取締役社長である方永義を含めた7名の取締役と3名の監査役で構成される経営陣で運営されており、代表取締役社長である方永義個人に依存した組織ではありません。しかしながら、同氏は、前職(株式会社永輝商事代表取締役)までの経営者としての経験・人脈を生かし、当社グループの新規営業先の開拓、グローバルな事業展開において重要な役割を果たしております。従いまして、何らかの理由により同氏の業務遂行が困難となった場合には、当社グループの業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

⑩ 事故、災害等による操業への影響に関するリスク

当社グループの生産設備の中には、ウェーハ事業の炉など高温、高圧での操業を行なっている設備があります。また、ウェーハを加工するうえで多量の化学薬品等を取り扱っています。対人・対物を問わず、事故の防止対策には万全を期しておりますが、万一重大な事故が発生した場合には、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を与えるリスクがあります。また、国内外の製造拠点等において、大規模地震や台風等の自然災害、新型インフルエン

ザ等の感染症、その他当社グループの制御不能事態により操業に支障が生じた場合には、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を与えるリスクがあります。

⑪ 公募増資資金の使途に関するリスク

平成27年2月17日及び平成27年3月3日開催の取締役会において決議された公募増資による調達資金は、主に台湾子会社の設備投資に充当する方針であります。台湾子会社においては現地事情に詳しい組織や提携先のネットワークを最大限に活用して、工場稼働に向けて準備を進めておりますが、今後客先動向など当社グループを取り巻く環境が変化した場合には、当社グループの調達資金の一部が上記以外の目的に使用される可能性があります。

⑫ 財務制限条項に関するリスク

当社は、事業に必要な資金調達のため、平成26年3月に金融機関との間でコミットメント期間付タームローン及びシンジケートローン契約を締結しており、これらの借入契約には、純資産の維持及び経常利益の確保に関して財務制限条項が付加されております。今後、当社グループの経営成績が著しく悪化するなどして財務制限条項に抵触した場合、借入先金融機関の請求により当該借入について期限の利益を喪失し、一括返済を求められるなどして、財政状況及び業績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑬ 有利子負債への依存及び金利水準の動向に関するリスク

当社グループは、主に金融機関からの借入金によって事業資金を調達しており、総資産に占める有利子負債の割合は、第5期連結会計年度において55.0%であります。当社グループでは、金利等の動向を注視しつつ、将来の環境変化にも柔軟な対応が可能な調達形態の維持・構築に努めております。しかしながら、事業の規模拡大に伴う資金需要により、有利子負債の割合が上昇するとともに、金利水準の上昇により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑭ 関連当事者取引について

第5期連結会計年度において、当社と方永義、鈴木正行、本郷邦夫及び株式会社永輝商事の間で関連当事者取引があり、重要なものは以下のとおりであります。

当連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)

関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員及び 個人主要 株主	方 永義	-	-	当社代表 取締役社長	(被所有) 直接 (19.7)	債務被保証	当社銀行借 入等に対す る債務被保 証(注)1	2,678,071	-	-
役員	鈴木 正行	-	-	当社取締役	(被所有) 直接 (0.2)	資金の貸付	資金の貸付 (注)2	39,086	長期貸付金	45,809
							利息の受取 (注)2	279	その他流動 資産	279
	本郷 邦夫	-	-	当社取締役	(被所有) 直接 (1.0)	資金の貸付	資金の貸付 (注)2	16,971	長期貸付金	19,890
							利息の受取 (注)2	121	その他流動 資産	121
役員が議 決権の過 半数を自 己の計算 において 所有して いる会社	株式会社 永輝商事 (注)3	東京都 品川区	98,000千円	ソーラーパネ ル・シリコン リサイクル・ 太陽光発電導 入事業	なし	仕入先	販売用ウェー ハの原材料仕 入(注)4	21,878	-	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 当社は、銀行借入等に対して当社代表取締役社長 方 永義より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。
2. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

なお、貸付は外貨（USD）で行われており、その期末残高は545千USD（期末換算レート120.55円）です。

3. 株式会社永輝商事は、当社代表取締役社長 方永義が議決権の68.3%を直接保有しております。
4. 独立第三者取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
5. 取引金額については消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員	鈴木 正行	-	-	艾爾斯半導體 股份有限公司 董事長	(被所有) 直接 (11.2)	役員の兼任 出資の引受	出資の引受 (注) 1	37,744	-	-
						債務被保証	銀行借入に 対する債務 被保証 (注) 2	542,880	-	-
	本郷 邦夫	-	-	艾爾斯半導體 股份有限公司 董事	(被所有) 直接 (4.8)	役員の兼任 出資の引受	出資の引受 (注) 1	16,176	-	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 艾爾斯半導體股份有限公司との取引は、同社設立のための出資を引き受けたものであります。
なお、出資は外貨（新台幣ドル）で行われており、取引金額は出資時換算レート3.37円で円換算後の金額です。
2. 艾爾斯半導體股份有限公司の銀行借入に対して、艾爾斯半導體股份有限公司董事長 鈴木 正行より債務保証を受けております。なお、艾爾斯半導體股份有限公司は保証料の支払は行っておりません。

当社は、銀行借入等に対して当社代表取締役社長方永義より債務保証を受けております。なお、債務保証に伴う保証料は支払っておりません。今後は金融機関との交渉により当該債務保証を解消していく方針であります。

株式会社永輝商事は、当社代表取締役社長方永義が議決権の過半数を保有しております。同社から販売用ウェーハの原材料仕入れを行っており、第5期連結会計年度における仕入取引金額の売上原価に占める割合は、0.8%であります。販売用ウェーハの原材料仕入取引につきましては、当社は同社からシリコンウェーハの製造過程等で生じる販売に適さない格落品を購入しております。同社は、各種素材のリサイクルを事業として行っており、シリコンウェーハの格落品について独自の仕入れルートを有していることから、現状継続購入しております。なお、関連当事者取引等の実施につきましては、その取引が当社の経営の健全性を損なっていないか、その取引が合理的判断に照らし合わせて有効であるか、また取引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等に留意して、当社取締役会の決議により実施しております。

2. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

当社は、「地球環境を大切にし、世界の人々に信頼され、常に創造し挑戦する」ことを経営の基本理念とし、「多様性を尊重し、自由闊達な企業風土をつくり、「就業環境No.1」を目指す」「エコロジー事業を通して環境に優しい総合エコソリューション企業として世界をリードし、人々の豊かな生活に貢献する」「公正、信用を重視し、社会を利する事業を進める」ことを行動指針としております。当社は、この経営の基本理念及び行動指針に従い、社会的な責任を遂行し企業価値を最大化することを経営方針としております。

(2) 目標とする経営指標

当社グループは、更なる成長を続けることにより企業価値の最大化を図るため、売上高、売上高営業利益率、1株当たり当期純利益、ROE（自己資本利益率）、ROA（総資本利益率）を重要な経営指標としております。

(3) 中長期的な会社の経営戦略

当社の事業は半導体の市場と相関がありますが、半導体デバイスは、パソコン、携帯電話、スマートフォン、ゲーム機、デジタル家電、へと急速に広がり、そうした機器の需要は世界的に拡大しております。

今後も、世界人口の増加と新興国の経済発展に伴う需要、および先進国の更なるデバイス用途（ロボットの多様化・

自動車・家・街・M2M・・・等)の広がりにより、増加が継続することが予測されております。

半導体需要の増加に伴い、その基盤となるシリコンウェーハもまた需要が拡大し、再生需要も増加が予測されております。

現在、顧客需要に対し供給不足となっております。中期的には、三本木工場の増設および台湾工場の新設と大規模な設備投資により生産力を増強します。

三本木工場は平成27年3月から、台湾工場は平成27年6月から稼働しますが、現在の生産力に比較して70%増となります。また、三本木工場の新規設備には次世代の450mmウェーハの加工装置も含まれており、世界に先駆けて製造を行う予定であります。

長期的には、増設・新設後の工場をフル稼働し、再生市場でのシェア拡大を目指します。

(4) 会社の対処すべき課題

当社グループの主要な事業であるシリコンウェーハの再生事業は、半導体市場の影響を受けます。足許において、世界の長期的な半導体需要は増加傾向にあり、半導体メーカーからの需要も増加しております。このようななか、当社グループとしては国内国外を問わず半導体メーカーの需要を取り込む必要があります。また、日々進歩している微細化技術の開発や18インチ(450mm)ウェーハの開発等の技術革新にも対応していく必要があります。当社グループはこのような経営環境の中で以下の事項を対処すべき課題として認識しております。

① 技術開発

- a. 世界最先端の微細化技術に適応する12インチ(300mm)ハイエンド向け再生技術を開発、事業化すること。
- b. 18インチ(450mm)ウェーハの再生技術を開発、事業化すること。

② 営業施策

- a. アメリカ・欧州・台湾・シンガポール・中国・韓国をはじめとする海外との取引を更に強化すること。
- b. 大手半導体デバイスメーカーとの安定的取引を確保すること。
- c. モニタウェーハ及びターゲット材(※)・ケミカル消耗品の販売を強化すること。
- d. 半導体関連商品の販売を強化すること。

③ 製造体制

- a. 半導体デバイスの高集積度化に対応すること。
- b. 最先端設備を拡充すること。
- c. 高度な知識・技能を有する人材を確保すること。

④ 海外進出

- a. 主要な半導体メーカーの需要に適時に対応するため海外進出をすること。

※ターゲット材 半導体を加工する時の補助材料

3. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

当連結会計年度 (平成26年12月31日)	
資産の部	
流動資産	
現金及び預金	※2 1,190,277
受取手形及び売掛金	※2 696,764
商品及び製品	376,262
仕掛品	67,869
原材料及び貯蔵品	79,532
繰延税金資産	50,141
その他	298,468
流動資産合計	2,759,317
固定資産	
有形固定資産	
建物及び構築物	8,756
減価償却累計額	△1,777
建物及び構築物（純額）	6,978
機械装置及び運搬具	659,915
減価償却累計額	※4 △298,311
機械装置及び運搬具（純額）	※1 361,604
工具、器具及び備品	7,499
減価償却累計額	△1,411
工具、器具及び備品（純額）	6,088
建設仮勘定	※2 3,543,784
有形固定資産合計	3,918,455
無形固定資産	
ソフトウェア	15,489
無形固定資産合計	15,489
投資その他の資産	
長期貸付金	65,699
その他	64,677
投資その他の資産合計	130,377
固定資産合計	4,064,322
資産合計	6,823,640

(単位：千円)

当連結会計年度
(平成26年12月31日)

負債の部	
流動負債	
支払手形及び買掛金	151,225
短期借入金	※2 483,180
1年内返済予定の長期借入金	※2,3 344,049
未払金	767,303
未払法人税等	408,323
賞与引当金	11,449
その他	127,324
流動負債合計	2,292,855
固定負債	
長期借入金	※2,3 2,925,959
繰延税金負債	7,750
その他	979
固定負債合計	2,934,689
負債合計	5,227,545
純資産の部	
株主資本	
資本金	199,000
資本剰余金	198,990
利益剰余金	1,114,008
株主資本合計	1,511,998
その他の包括利益累計額	
為替換算調整勘定	23,776
その他の包括利益累計額合計	23,776
少数株主持分	60,320
純資産合計	1,596,094
負債純資産合計	6,823,640

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)

	当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
売上高	4,566,080
売上原価	※1,3 2,746,263
売上総利益	1,819,817
販売費及び一般管理費	※2,3 653,736
営業利益	1,166,080
営業外収益	
受取利息	623
為替差益	207,531
補助金収入	44,469
その他	6,083
営業外収益合計	258,707
営業外費用	
支払利息	28,098
シンジケートローン手数料	125,120
その他	23,623
営業外費用合計	176,841
経常利益	1,247,946
特別損失	
設備移設費用	19,643
特別損失合計	19,643
税金等調整前当期純利益	1,228,303
法人税、住民税及び事業税	610,073
法人税等調整額	△46,031
法人税等合計	564,042
少数株主損益調整前当期純利益	664,261
当期純利益	664,261

連結包括利益計算書

(単位：千円)	
当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)	
少数株主損益調整前当期純利益	664,261
その他の包括利益	
為替換算調整勘定	30,176
その他の包括利益合計	※1 30,176
包括利益	694,437
(内訳)	
親会社株主に係る包括利益	688,037
少数株主に係る包括利益	6,400

(3) 連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)

(単位:千円)

	株主資本				その他の包括利益累計額		少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	100,000	99,990	449,747	649,737	—	—	—	649,737
当期変動額								
新株の発行	99,000	99,000		198,000				198,000
当期純利益			664,261	664,261				664,261
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)					23,776	23,776	60,320	84,096
当期変動額合計	99,000	99,000	664,261	862,261	23,776	23,776	60,320	946,357
当期末残高	199,000	198,990	1,114,008	1,511,998	23,776	23,776	60,320	1,596,094

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)	
当連結会計年度	
(自 平成26年1月1日	
至 平成26年12月31日)	
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前当期純利益	1,228,303
減価償却費	102,535
受取利息及び受取配当金	△623
補助金収入	△44,469
支払利息	28,098
為替差損益(△は益)	△82,820
シンジケートローン手数料	125,120
売上債権の増減額(△は増加)	△17,987
たな卸資産の増減額(△は増加)	△85
仕入債務の増減額(△は減少)	12,452
未払金の増減額(△は減少)	△51,348
未収消費税等の増減額(△は増加)	△133,017
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,260
その他	△55,683
小計	1,111,735
利息及び配当金の受取額	221
利息の支払額	△24,593
補助金の受取額	44,469
法人税等の支払額	△488,481
営業活動によるキャッシュ・フロー	643,351
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	△217,922
有形固定資産の取得による支出	△2,901,031
無形固定資産の取得による支出	△1,276
貸付けによる支出	△56,058
敷金及び保証金の差入による支出	△32,265
保険積立金の積立による支出	△7,225
その他	△13
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,215,793
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	470,180
長期借入れによる収入	2,619,298
長期借入金の返済による支出	△146,904
株式の発行による収入	196,447
シンジケートローン手数料の支払額	△125,120
少数株主からの払込みによる収入	53,920
その他	△827
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,066,993
現金及び現金同等物に係る換算差額	78,480
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	573,032
現金及び現金同等物の期首残高	377,995
現金及び現金同等物の期末残高	※ 951,027

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1. 連結の範囲に関する事項

全ての子会社を連結の対象としており、その内容は次のとおりであります。

(1) 連結子会社の数及び名称

連結子会社の数 1社

連結子会社の名称 艾爾斯半導體股份有限公司

当連結会計年度より、新たに設立した艾爾斯半導體股份有限公司を連結の範囲に含めております。

(2) 主要な非連結子会社の名称

該当事項はありません。

2. 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

a. 商品

個別法

b. 製品・仕掛品・原材料

総平均法

c. 貯蔵品

最終仕入原価法

②デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 3～20年

機械装置及び運搬具 2～17年

工具、器具及び備品 3～5年

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、ソフトウェア（自社利用目的分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

なお、当連結会計年度における引当金残高はありません。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う額を計上しております。

(4) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

金利スワップについては特例処理の要件を満たしているため、特例処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 金利スワップ

ヘッジ対象 借入金の支払利息

③ ヘッジ方針

変動金利の借入金の支払利息に係る金利変動リスクをヘッジすることを目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。

④ ヘッジ有効性評価の方法

特例処理によっている金利スワップであるため、有効性の評価は省略しております。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めております。

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(7) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

(追加情報)

該当事項はありません。

(連結貸借対照表関係)

※1 国庫補助金による固定資産圧縮記帳額

	当連結会計年度 (平成26年12月31日)
機械装置及び運搬具	28,109千円

※2 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

	当連結会計年度 (平成26年12月31日)
現金及び預金（定期預金）	239,249千円
受取手形及び売掛金	1,164
建設仮勘定	651,456
計	891,869

(注) 定期預金19,245千円について、艾爾斯半導體股份有限公司が科技部南部科學工業園區管理局との間で締結した土地賃貸借契約に基づく債務に対し質権を設定しております。

担保債務は、次のとおりであります。

	当連結会計年度 (平成26年12月31日)
短期借入金	188,500千円
1年以内返済予定の長期借入金	81,681
長期借入金	747,755
計	1,017,937

※3 財務制限条項

当社が締結しているコミットメント期間付タイムローン及びシンジケートローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。

(借入枠6,067,000千円、借入実行残高1,972,000千円、借入未行使残高4,095,000千円)

- (1) 各年度の決算期末日における単体の貸借対照表の「純資産の部」の合計金額を、直前の決算期の末日又は2012年12月期に終了する決算期の末日いずれか大きい方の75%以上に維持すること。
- (2) 各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される「経常損益」が、2期連続して損失とならないようにすること。

※4 減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額は減損損失累計額を含んで表示しております。

(連結損益計算書関係)

- ※1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切り下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。

	当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
売上原価	44,329千円

- ※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は、次のとおりであります。

	当連結会計年度 (平成26年12月31日)
役員報酬	111,948千円
給与手当	57,302
賞与	17,544
運賃及び荷造費	275,351
旅費及び交通費	47,756
支払手数料	50,452
賞与引当金繰入額	910

※3 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)	
	6,283千円

(連結包括利益計算書関係)

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)	
為替換算調整勘定	
当期発生額	30,176千円
組替調整額	-
その他の包括利益合計	30,176

(連結株主資本等変動計算書関係)

当連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度 期首株式数 (株)	当連結会計年度 増加株式数 (株)	当連結会計年度 減少株式数 (株)	当連結会計年度 期末株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	10,000	5,100,000	-	5,110,000
合計	10,000	5,100,000	-	5,110,000

(変動事由の概要)

普通株式の発行済株式の増加5,100,000株は、有償第三者割当増資による増加220株、株式分割による増加5,099,780株であります。

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 配当に関する事項

該当事項はありません。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)	
現金及び預金	1,190,277千円
預入期間が3か月を超える 定期預金	△239,249
現金及び現金同等物	951,027

(金融商品関係)

当連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

デリバティブ取引は、事業遂行上のリスクをヘッジする目的で利用しており、売買益を目的とした投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、債権管理規程に従い相手先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、信用状況を把握する体制としております。

営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

借入金には主に設備投資に係る資金調達です。長期借入金のうち金利変動リスクに晒されているものの一部については、当該リスクを回避する目的でデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用しております。

外貨建預金は、為替リスクに晒されておりますが、定期的に通貨別の換算額を把握し、継続的にモニタリングすることによって管理しております。

外貨建金銭債権債務は、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。

(3) 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)

財務経理部が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

当連結会計年度(平成26年12月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	1,190,277	1,190,277	-
(2) 受取手形及び売掛金	696,764	696,764	-
資産計	1,887,041	1,887,041	-
(1) 支払手形及び買掛金	151,225	151,225	-
(2) 短期借入金	483,180	483,180	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	344,049	344,049	-
(4) 未払金	767,303	767,303	-
(5) 未払法人税等	408,323	408,323	-
(6) 長期借入金	2,925,959	2,841,996	△83,962
負債計	5,080,039	4,996,078	△83,962
デリバティブ取引 ヘッジ会計が適用されていないもの	5,599	5,599	-
デリバティブ取引	5,599	5,599	-

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

負 債

(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)1年内返済予定の長期借入金、(4)未払金、(5)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(6)長期借入金

長期借入金の時価については、残存期間における元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。金利スワップの特例処理の対象とされているものについては、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。

2. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

当連結会計年度(平成26年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	1,190,277	-	-	-
受取手形及び売掛金	696,764	-	-	-
合計	1,887,041	-	-	-

3. 長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
当連結会計年度(平成26年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	483,180	-	-	-	-	-
長期借入金	344,049	530,928	528,668	486,298	415,644	964,418
合計	827,229	530,928	528,668	486,298	415,644	964,418

(デリバティブ取引関係)

当連結会計年度(自平成26年1月1日至平成26年12月31日)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	1,160,368	-	5,599	5,599

(注) 期末の時価の算定については、先物為替相場を使用しております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 金利関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
金利スワップの特 例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	150,000	110,000	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

(ストック・オプション等関係)

1. 費用計上額及び科目名

ストック・オプションを付与した時点においては、当社は未公開企業であり、ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしていません。

2. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

当連結会計年度（平成26年12月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

なお、平成26年9月9日に1株を500株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。

(1) ストック・オプションの内容

会社名	提出会社
決議年月日	平成26年6月16日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 4名 当社従業員 25名
株式の種類及び付与数(株)	普通株式 197,000
付与日	平成26年6月16日
権利確定条件	新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
対象勤務期間	自平成26年6月16日 至平成28年6月16日
権利行使期間	自平成28年6月17日 至平成36年6月16日

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度（平成26年12月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

① ストック・オプションの数

会社名	提出会社
決議年月日	平成26年6月16日
権利確定前	
前連結会計年度末(株)	—
付与(株)	197,000
失効(株)	—
権利確定(株)	—
未確定残(株)	197,000
権利確定後	
前連結会計年度末(株)	—
権利確定(株)	—
権利行使(株)	—
失効(株)	—
未行使残(株)	—

② 単価情報

会社名	提出会社
決議年月日	平成26年6月16日
権利行使価格(円)	400
行使時平均株価(円)	—
付与日における公正な評価単価(円)	—

3. 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

ストック・オプション付与日時点において、当社は未公開企業であるため、付与日における公正な評価単価は、単位当たりの本源的価値の見積方法によっております。

また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、簿価純資産法及び類似会社比準法により算出した結果を総合的に勘案して算定しております。

4. スtock・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実際の失効数のみ反映させる方式を採用しております。

5. スtock・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度における本源的価値の合計額及び当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額

275,800千円

(2) 当連結会計年度中において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

- 千円

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (平成26年12月31日)
繰延税金資産	
たな卸資産	15,799千円
未払事業税	22,669
未払費用	7,592
賞与引当金	4,080
減価償却費	4,542
繰越欠損金	7,136
その他	1,440
繰延税金資産小計	63,260千円
評価性引当額	△10,701千円
繰延税金資産合計	52,559千円
繰延税金負債	
為替差益	△10,168千円
繰延税金負債合計	△10,168千円
繰延税金資産純額	42,390千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	当連結会計年度 (平成26年12月31日)
法定実効税率	38.0%
(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%
評価性引当額の増減	0.7%
留保金課税	4.2%
連結子会社との税率差異	0.6%
その他	2.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	45.9%

3. 法人税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。また、当社は平成26年9月3日付の新株発行により資本金が1億円超となり、平成27年1月1日以降に開始する連結会計年度から外形標準課税制度の適用を受けます。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の39.4%から35.6%となります。

この税率変更による影響額は軽微であります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、報告セグメントを「ウェーハ事業」及び「ソーラー事業」の2事業としております。「ウェーハ事業」は、半導体用シリコンウェーハの再生、加工及び販売を行っております。「ソーラー事業」は、自社工場メガソーラー発電所による売電を行っております。

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

当連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			その他(注) 1	合計	調整額 (注)2	連結財務諸表 計上額
	ウェーハ事業	ソーラー事業	計				
売上高							
外部顧客への売上高	4,414,457	40,621	4,455,078	111,002	4,566,080	-	4,566,080
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	-	-	-	-
計	4,414,457	40,621	4,455,078	111,002	4,566,080	-	4,566,080
セグメント利益	1,444,913	22,478	1,467,392	38,815	1,506,207	△340,126	1,166,080
セグメント資産	5,040,036	236,770	5,276,806	145,681	5,422,488	1,401,151	6,823,640
その他の項目							
減価償却費	83,740	14,861	98,601	-	98,601	3,933	102,535
減損損失	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,555,426	-	3,555,426	-	3,555,426	1,276	3,556,703

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、半導体生産設備の買取・販売と技術コンサルティングであります。

2. 調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額は、各報告セグメントには配賦していない全社費用であります。

全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配賦していない全社資産であります。

全社資産は主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金並びに管理部門に係る資産等であります。

(3) 減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産に係る増加額であります。

3. セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

当連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本	台湾	欧米	その他のアジア	合計
1,199,549	1,936,026	1,046,833	383,671	4,566,080

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位：千円)

日本	台湾	合計
2,808,065	1,110,389	3,918,455

3 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd	1,749,938	ウェーハ事業
ソニーセミコンダクタ株式会社	507,208	ウェーハ事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

当連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)

関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又 は出資金	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員及び 個人主要 株主	方 永義	-	-	当社代表 取締役社長	(被所有) 直接 (19.7)	債務被保証	当社銀行借 入等に対す る債務被保 証(注)1	2,678,071	-	-
役員	鈴木 正行	-	-	当社取締役	(被所有) 直接 (0.2)	資金の貸付	資金の貸付 (注)2	39,086	長期貸付金	45,809
							利息の受取 (注)2	279	その他流動 資産	279
	本郷 邦夫	-	-	当社取締役	(被所有) 直接 (1.0)	資金の貸付	資金の貸付 (注)2	16,971	長期貸付金	19,890
							利息の受取 (注)2	121	その他流動 資産	121
役員が議 決権の過 半数を自 己の計算 において 所有して いる会社	株式会社 永輝商事 (注)3	東京都 品川区	98,000千円	ソーラーパネ ル・シリコン リサイクル・ 太陽光発電導 入事業	なし	仕入先	販売用ウェー ハの原材料仕 入(注)4	21,878	-	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 当社は、銀行借入等に対して当社代表取締役社長 方 永義より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。
2. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
なお、貸付は外貨(USD)で行われており、その期末残高は545千USD(期末換算レート120.55円)です。
3. 株式会社永輝商事は、当社代表取締役社長 方 永義が議決権の68.3%を直接保有しております。
4. 独立第三者取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
5. 取引金額については消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又 は出資金	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員	鈴木 正行	-	-	艾爾斯半導體 股份有限公司 董事長	(被所有) 直接 (11.2)	役員の兼任 出資の引受	出資の引受 (注)1	37,744	-	-
						債務被保証	銀行借入に 対する債務 被保証(注) 2	542,880	-	-
	本郷 邦夫	-	-	艾爾斯半導體 股份有限公司 董事	(被所有) 直接 (4.8)	役員の兼任 出資の引受	出資の引受 (注)1	16,176	-	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 艾爾斯半導體股份有限公司との取引は、同社設立のための出資を引き受けたものであります。
なお、出資は外貨(新台幣ドル)で行われており、取引金額は出資時換算レート3.37円で円換算後の金額です。
2. 艾爾斯半導體股份有限公司の銀行借入に対して、艾爾斯半導體股份有限公司取締役 鈴木 正行より債務保証を受けております。なお、艾爾斯半導體股份有限公司は保証料の支払は行っておりません。

(1株当たり情報)

	当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
1株当たり純資産額	300円54銭
1株当たり当期純利益金額	131円90銭

- (注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
2. 当社は平成26年8月12日開催の取締役会決議により、平成26年9月9日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額を算定しております。
3. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
1株当たり当期純利益金額	
当期純利益(千円)	664,261
普通株主に帰属しない金額(千円)	—
普通株式に係る当期純利益(千円)	664,261
普通株式の期中平均株式数(株)	5,036,164
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	平成26年6月16日決議 197,000株

(重要な後発事象)

当連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)

当社は、平成27年2月17日付で株式会社東京証券取引所から上場の承認を受け、平成27年3月24日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、平成27年2月17日及び平成27年3月3日開催の取締役会において、次のとおり決議し、公募による新株式発行については平成27年3月23日に払込が完了いたしました。

この結果、資本金は616,450千円、発行済株式総数は5,440,000株となっております。

1. 公募による募集株式発行

- | | |
|------------------|--|
| (1) 募集方法 | 一般募集(ブックビルディング方式による募集) |
| (2) 発行する株式の種類及び数 | 普通株式 330,000株 |
| (3) 発行価格 | 1株につき2,750円
一般募集はこの価格にて行いました。 |
| (4) 引受価額 | 1株につき2,530円
この価額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。 |
| (5) 発行価額 | 1株につき 2,167.50円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成27年3月3日開催の取締役会において決定された金額であります。 |
| (6) 資本組入額 | 1株につき1,265円 |
| (7) 発行価額の総額 | 715,275千円 |
| (8) 資本組入額の総額 | 417,450千円 |
| (9) 引受価額の総額 | 834,900千円 |

- (10) 払込期日 平成27年3月23日
- (11) 資金の使途 当社三本木工場の設備投資のため調達した借入金の返済資金及び連結子会社艾爾斯半導體股份有限公司に対する融資資金として充当することとし、艾爾斯半導體股份有限公司においてはシリコンウェーハ再生工場に係る設備投資資金（当該設備投資のため調達した借入金の返済資金を含む。）に充当する。

2. 第三者割当による新株式の発行

平成27年2月17日及び平成27年3月3日開催の取締役会において、株式会社SBI証券が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出（当社株主より借入れる当社普通株式162,000株）に関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を決議いたしました。

- (1) 発行する株式の種類及び数 当社普通株式 162,000 株（上限）
- (2) 割当価格 1株につき2,530円
- (3) 発行価額 1株につき2,167.50円
- (4) 資本組入額 1株につき1,265円
- (5) 払込金額の総額 409,860千円（上限）
- (6) 払込期日 平成27年4月24日
- (7) 割当先 株式会社SBI証券
- (8) 資金の使途 当社三本木工場の設備投資のため調達した借入金の返済資金及び連結子会社艾爾斯半導體股份有限公司に対する融資資金として充当することとし、艾爾斯半導體股份有限公司においてはシリコンウェーハ再生工場に係る設備投資資金（当該設備投資のため調達した借入金の返済資金を含む。）に充当する。
- (9) その他 株式会社SBI証券は、上場（売買開始）日から平成27年4月17日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。